

---

# 南亞電路板股份有限公司 2023年前三季營運概況

2023年11月16日



## 免責聲明

---

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



# 議程

---

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 2023年營運策略



# 公司概況

## 事業簡述

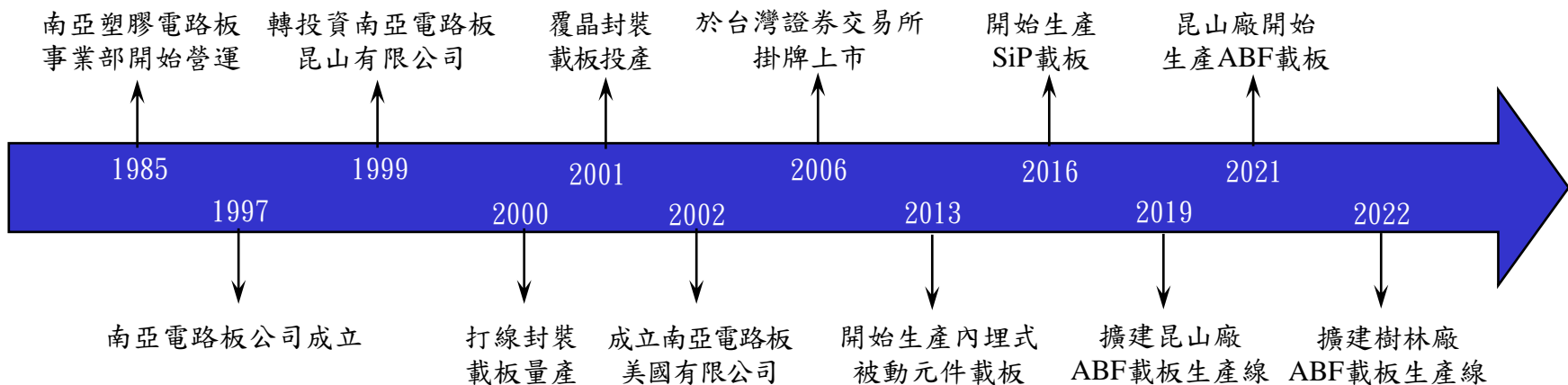
---

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2023年前三季合併營業額為新台幣 329.4億元。
- 台股上市市值：新台幣1,722.0億元(2023年9月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



# 公司概況

## 歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



# 財務狀況

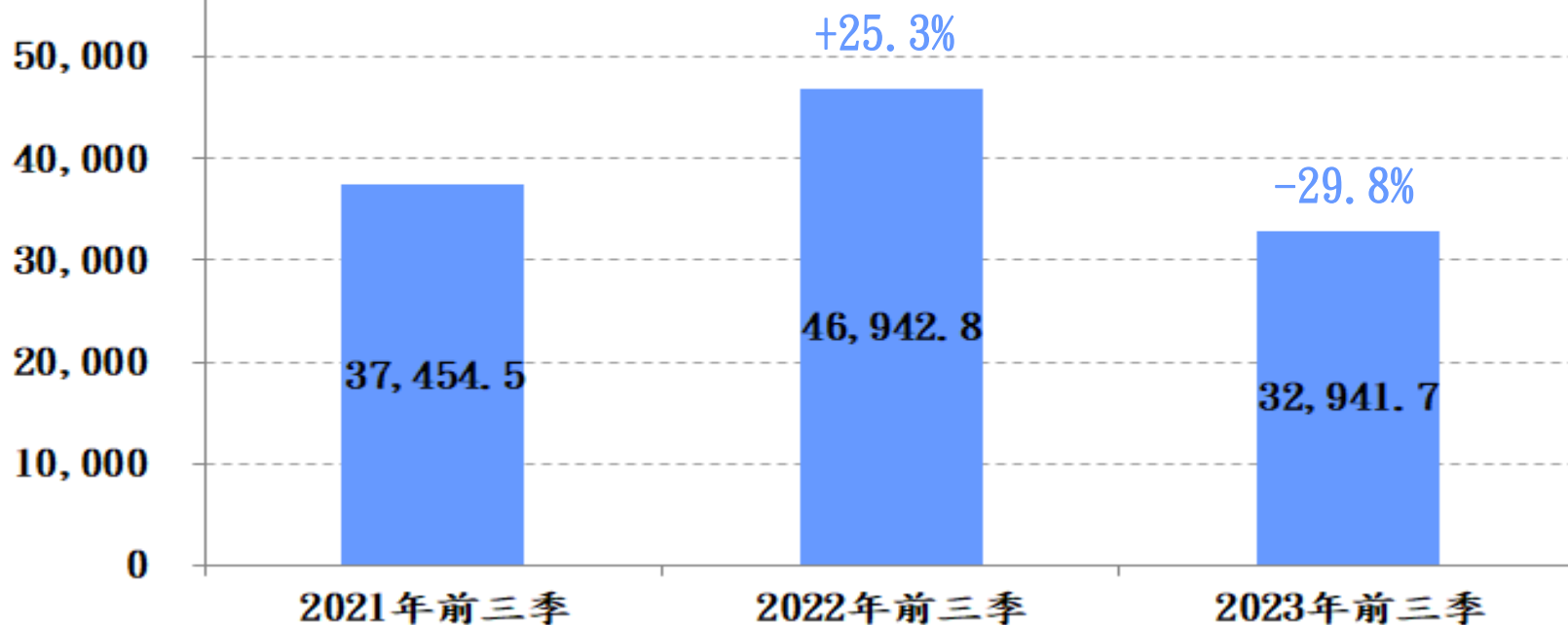
## 近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

60,000

■ 年成長率



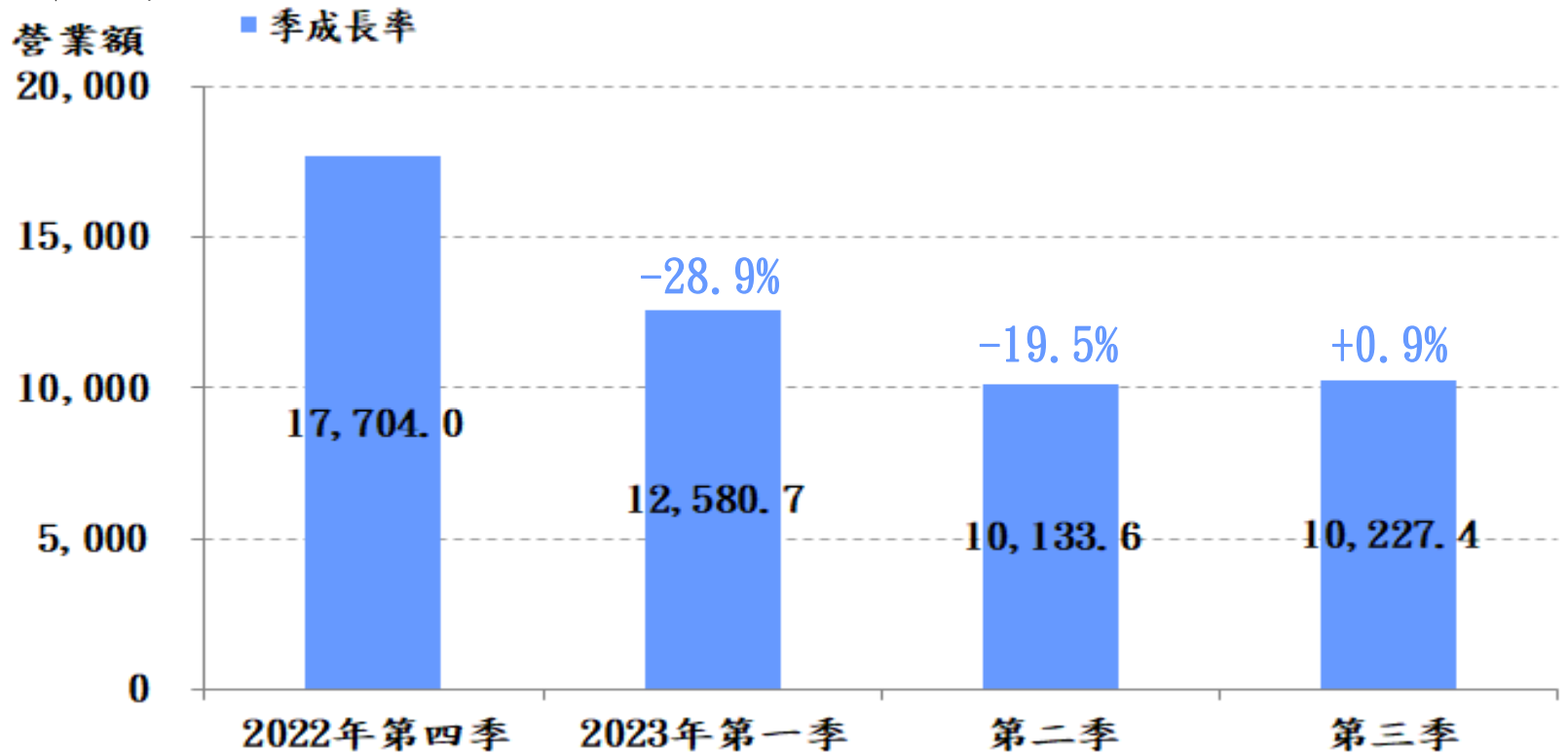
- 2022年前三季營收較2021年同期增加25.3%:  
本公司因高階電腦、網通應用產品銷售增加，高值化產品比重提高，致2022年前三季營收比2021年同期顯著成長。
- 2023年前三季營收較2022年同期減少29.8%:  
本公司受消費性電子庫存調整影響，相關應用產品銷售減少，致2023年前三季營收比2022年同期減少。



# 財務狀況

## 近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

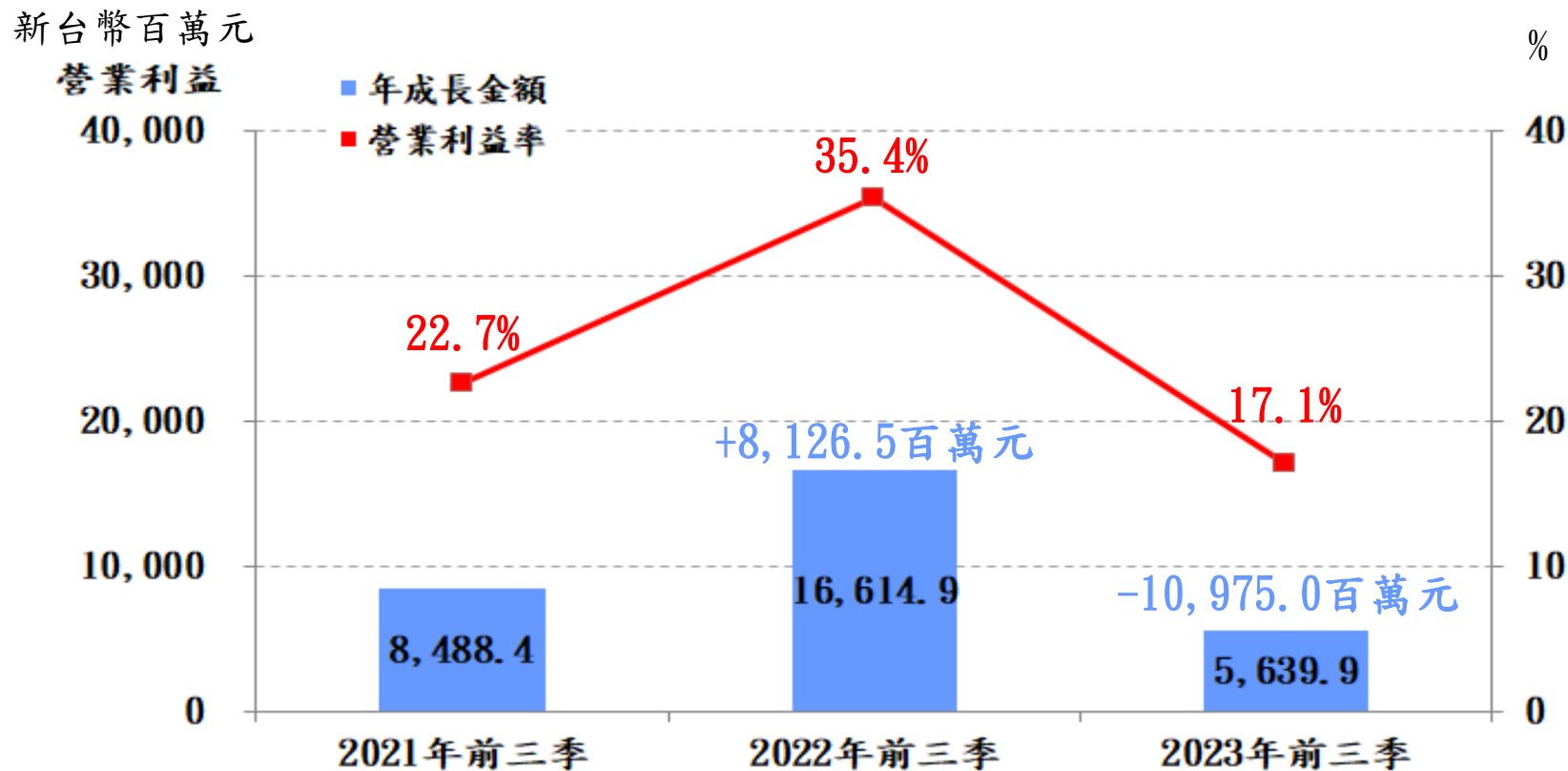


- 2023年第一季營收較2022年第四季減少28.9%:  
第一季受消費性電子庫存調整影響，營收比2022年第四季減少。
- 2023年第二季營收較2023年第一季減少19.5%:  
第二季因消費性電子產品庫存調整延長，營收比第一季再減少。
- 2023年第三季營收較2023年第二季增加0.9%:  
第三季因新世代電子產品推出，銷售增加，營收比第二季成長。



# 財務狀況

## 近三年營業利益



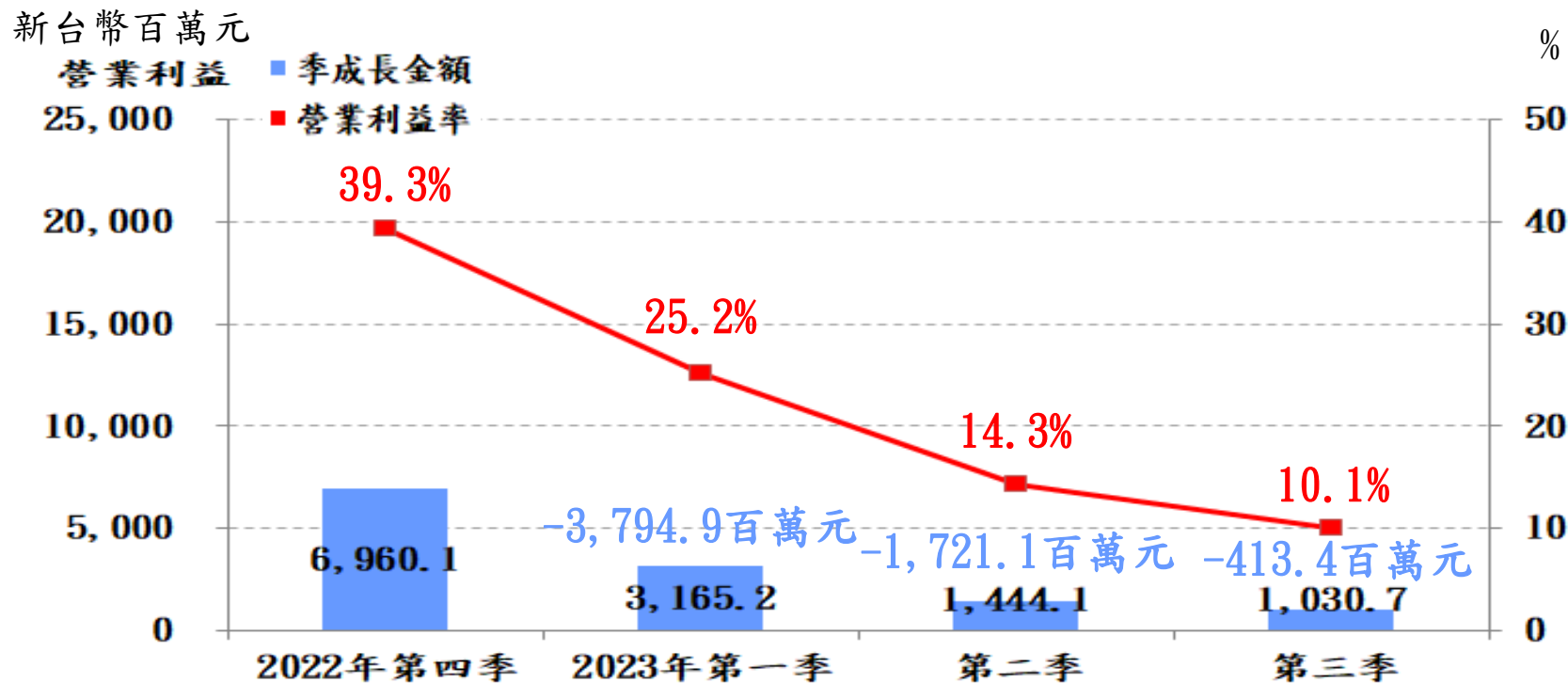
- 2022年前三季營業利益較2021年同期增加8,126.5百萬元：  
高階IC載板產能去瓶頸，產量增加，推升高值化產品銷售，營業利益顯著提升。
- 2023年前三季營業利益較2022年同期減少10,975.0百萬元：  
受消費性電子庫存調整影響，銷售量減少，致營業利益下滑。





# 財務狀況

## 近一年每季營業利益

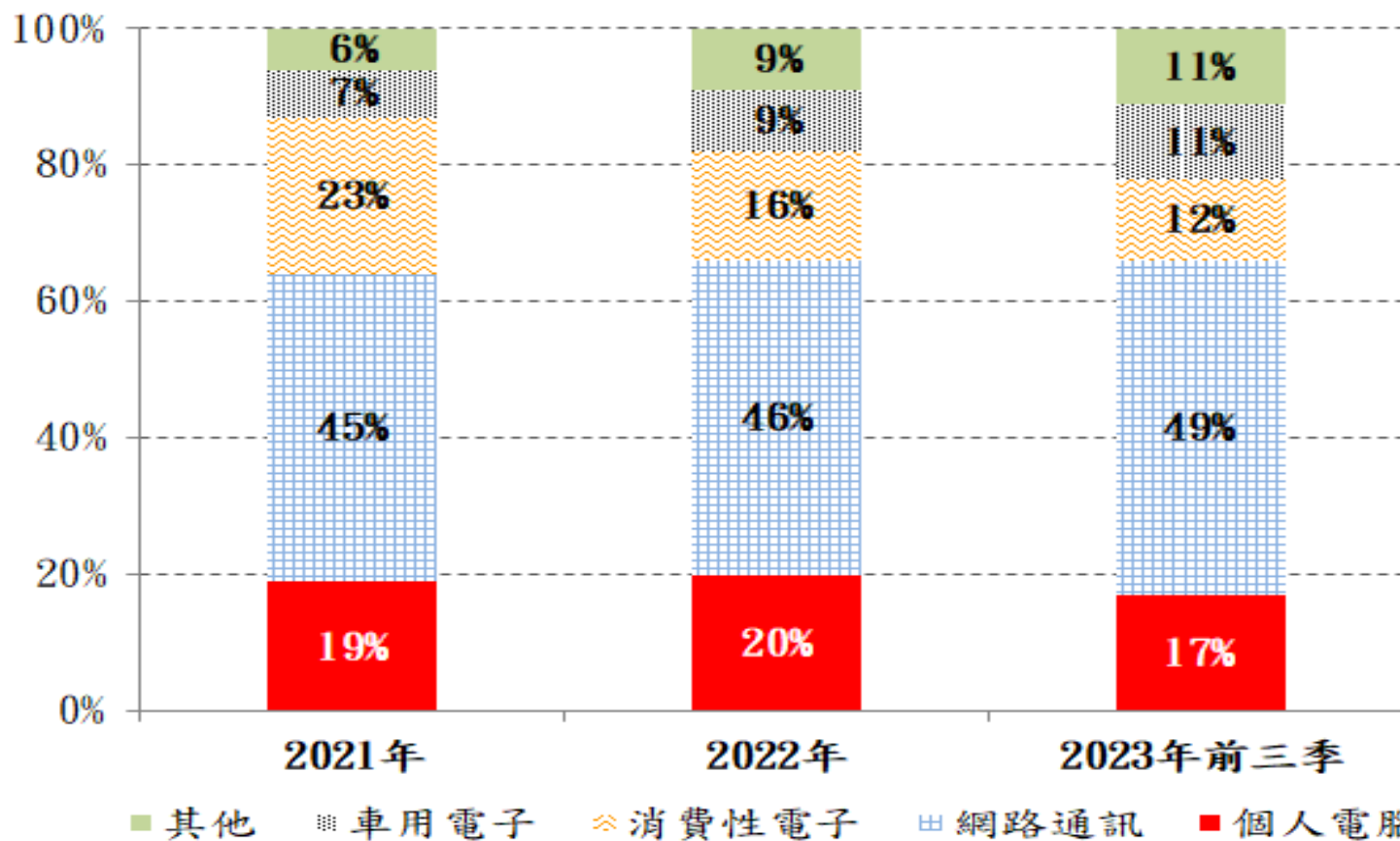


- 2023年第一季營業利益較2022年第四季減少3,794.9百萬元：  
受消費電子庫存調整與傳統淡季影響，第一季營業利益比前一季減少。
- 2023年第二季營業利益較2023年第一季減少1,721.1百萬元：  
個人電腦應用產品持續庫存調整，第二季營業利益比第一季下降。
- 2023年第三季營業利益較2022年第二季減少413.4百萬元：  
樹林新廠折舊費用增加，致第三季營業利益比第二季減少。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)

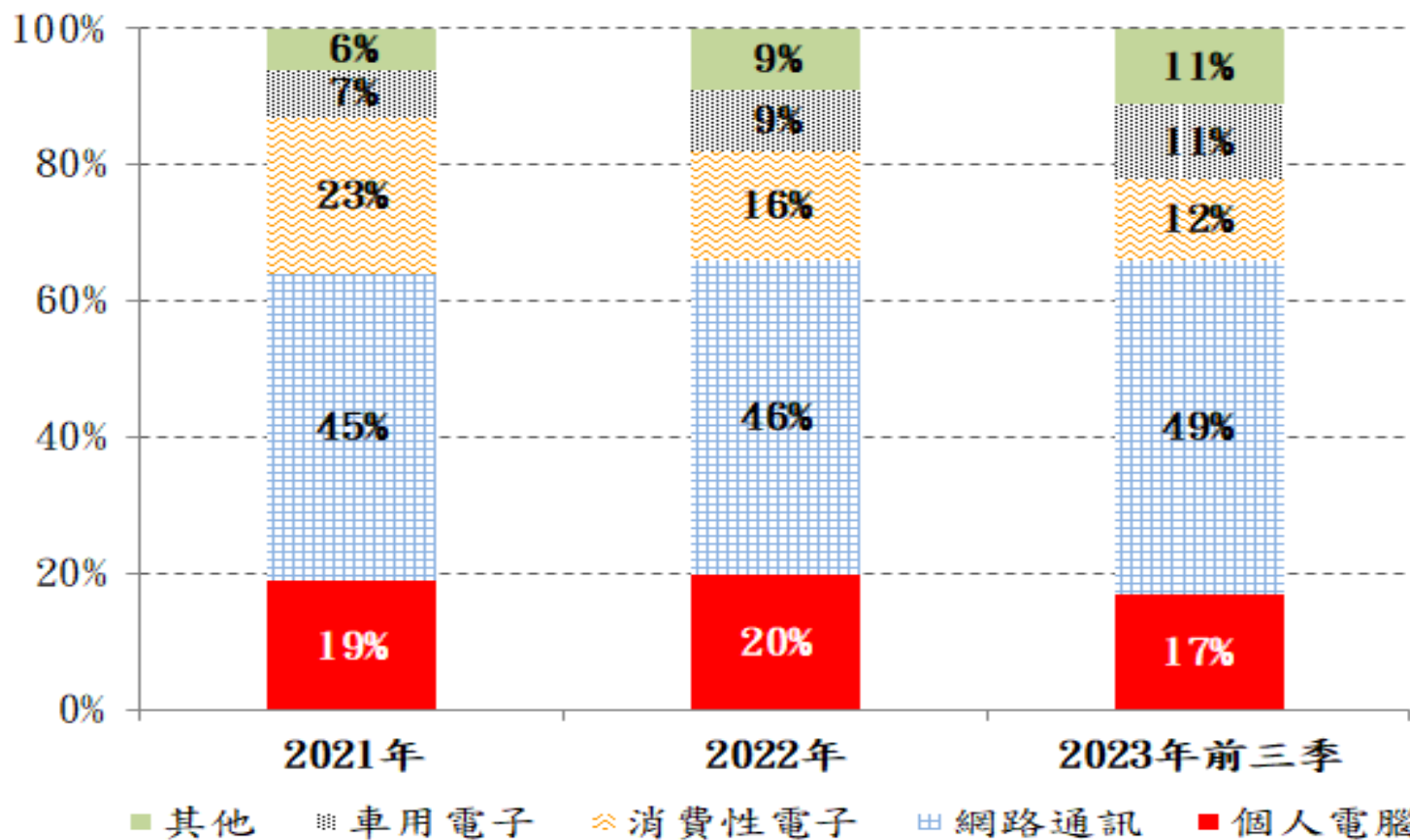


- 個人電腦、消費性電子去化庫存，影響銷售，致2023年前三季相關營收比重降低。
- 網通客戶需求穩健，本公司2023年前三季相關營收比重提升。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)



- 因電動車銷售增加，且汽車採用更多電子設備，車用電路板需求相對穩定，2023年前三季車用電子營收比重增加。
- 本公司積極爭取更多資料中心與邊緣運算商機，且高階IC載板產能增加，2023年前三季相關營收比重再成長。



# 產品未來發展方向

## 持續拓展高值化產品

### ■ ABF載板

將與客戶緊密合作，持續開發5奈米繪圖晶片、伺服器處理器、資料中心交換器、網路控制晶片及AI伺服器ASIC應用高階ABF載板，並致力於錦興廠升級與樹林廠二期提前量產，提高高值化產品生產量，進一步提升獲利。

### ■ BT載板

對IC針異質晶片封裝發展趨勢，本公司將開發新世代行動裝置的系統級封裝載板，並積極因應5G通訊需求，將量產5G光通訊收發模組，另與客戶共同開發車用電子產品，量產車用控制晶片載板，使產品更加多元。

### ■ 一般電路板

資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，本公司將開發並量產新世代伺服器網通卡與伺服器固態硬碟應用產品，並持續擴大車用電子應用產品銷售，量產功率模組電路板，以改善產品組合。



# 2023年營運策略

## 公司營運維持高度競爭力

---

- 增加專業人才，推動留才專案，再強化公司競爭力。
- 優化產品組合，積極拓展市場，創造產能最大效益。
- 善用智慧科技，加速數位轉型，推升公司營運效率。
- 強化營運韌性，超越治理指標，邁向公司永續發展。



感謝您的聆聽

